Der Bus als Kommunikationsmedium

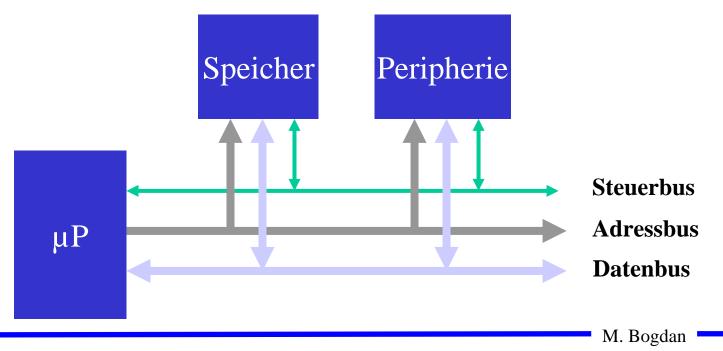
- O Bus ist eine Sammelleitung zur Übertragung von Daten zwischen mehreren Funktionseinheiten einer Rechenanlage
- O Es muss dafür gesorgt werden, dass
 - ⇒ verschiedene Geräte nicht gleichzeitig Daten senden
 - Bus Arbitrierung
 - ⇒ nur solche Geräte die Daten empfangen, für die sie bestimmt sind
 - Bus Protokoll
- O Ein Bus besteht in der Regel aus
 - **Datenleitungen**
 - **⇒** Adressleitungen
 - **⇒** Steuerleitungen

Rechner- und Gerätebusse

- O Busse verbinden Komponenten eines Rechnersystems
 - **⇒** Datenbus 8 bis 64 Bit
 - **⇒** Adressbus 16 bis 64 Bit
 - **⇒** Steuerbus
- Systembusse
 - **⇒** Busse, die rechnerinterne Komponenten verbinden
 - **⇒ AT-Bus PC/XT** (8088/ 8086)
 - **⇒ ISA-Bus AT (80286)**
 - **⇒ EISA** 80386 und 80486
 - **⇒ VESA ab 80486**
 - ⇒ PCI ab 80486 bis Pentium4
- Gerätebusse
 - **⇒** Busse, die externe Komponenten mit einem Rechnersystem verbinden
 - **⇒ IEC** Gerätebus
 - **⇒ EIDE** Festplatten
 - **⇒ SCSI** Geräte und Festplattenbus

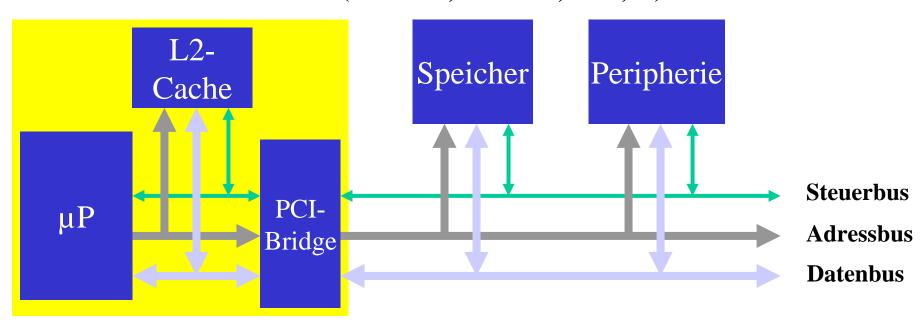
Systembusse

- **○** Verbindung der Komponenten innerhalb eines Rechnersystems
- Prozessorabhängige Busse
 - **⇒** Busschnittstelle des verwendeten Mikroprozessors
 - ⇒ einfach zu realisieren
 - **⇒** auf einen Prozessor zugeschnitten

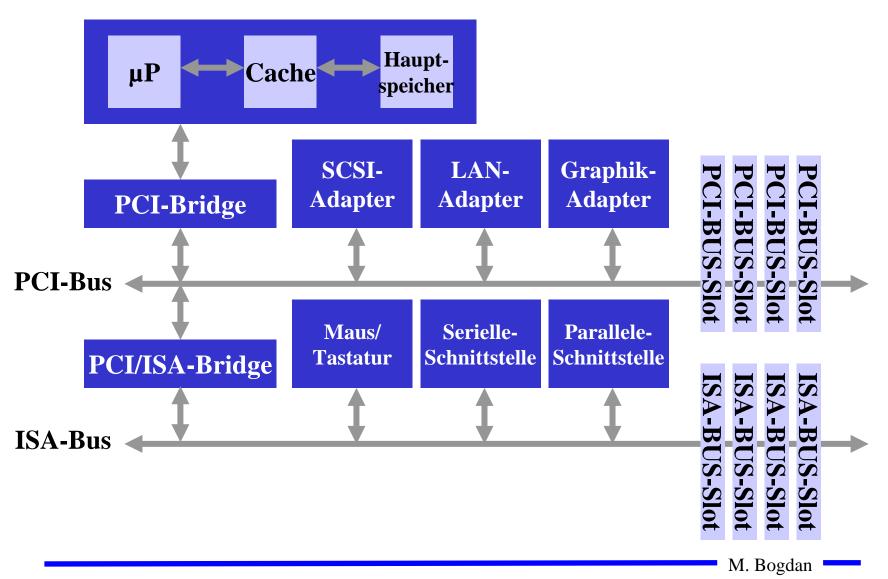


Prozessorunabhängige Systembusse

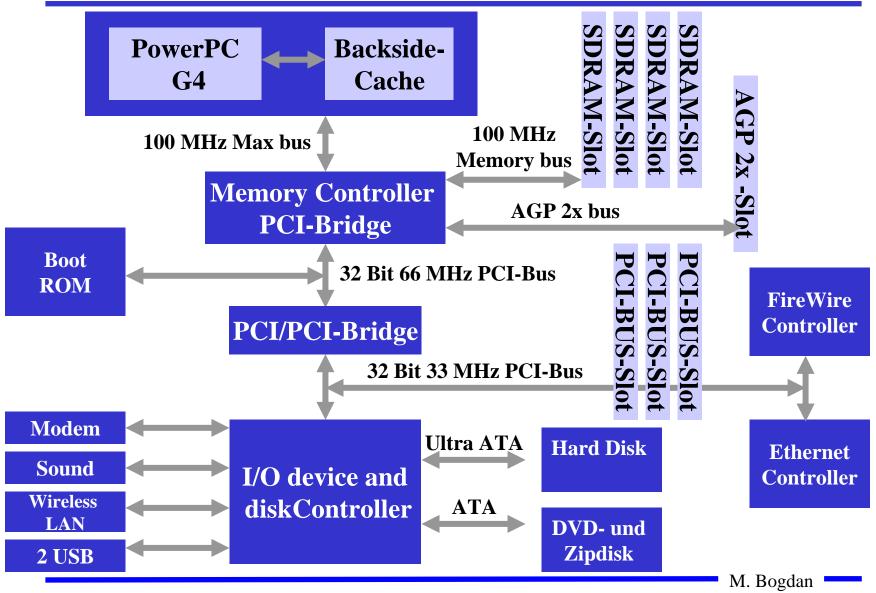
- O Der Prozessor ist über eine Bus Brücke mit den Komponenten verbunden
 - ⇒ z.B. PCI Bridge (Peripheral Component Interconnect)
 - ⇒ erhöhter Hardwareaufwand
 - ⇒ die Komponenten können für verschiedene Prozessoren verwendet werden (PPC 403, Pentium, I860, ...)



Beispiel: Busstruktur eines PC

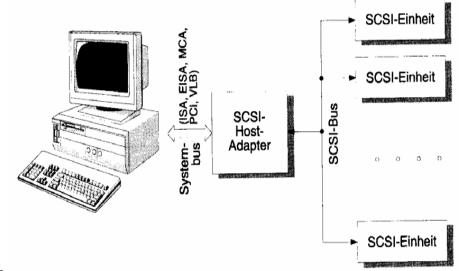


Beispiel: Busstruktur des Power Mac G4



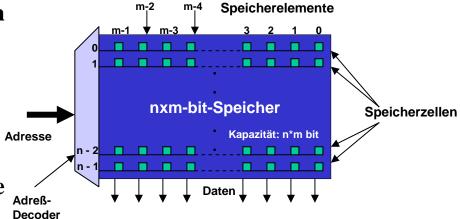
Gerätebusse: Der SCSI-Bus

- Small Computer Systems Interface
 - **⇒** Maximal 8 Einheiten
 - **⇒** 8 Bit Übertragung
 - **⇒** Identifikation durch SCSI-ID
 - ⇒ Terminierung durch Abschlußwiderstand
- Weitere SCSI-Standards
 - **⇒** SCSI-II
 - Erster richtiger Standard, der am gleichen Bus auch andere Geräte außer Festplatten berücksichtigt
 - **⇒** Fast SCSI
 - maximale Taktfrequenz wurde auf 10 MHz erhöht
 - **⇒** Wide SCSI
 - 16 Bit und 32 Bit Erweiterung der Datenbreite



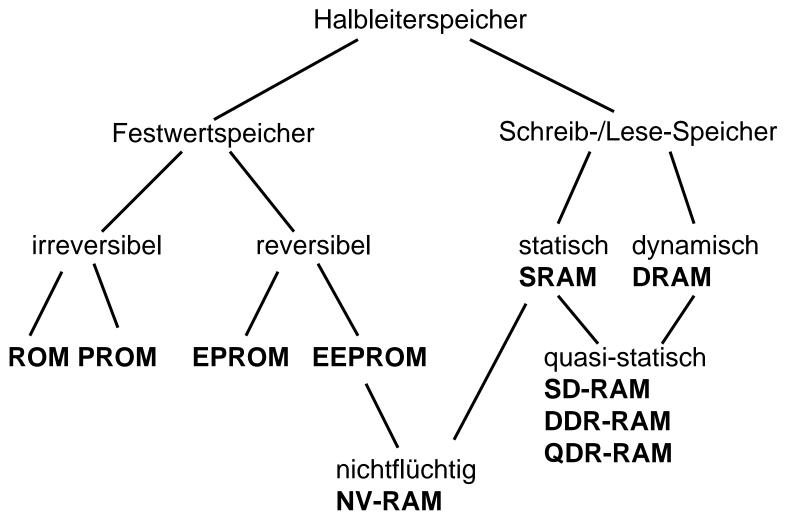
Aufbau von Speicherzellen

- Speicherung von Daten oder von logischen Funktionen
- Arten der Speicherung
 - ⇒ irreversibel programmierbare Speicherzellen
 - ⇒ reversibel programmierbare Speicherzellen
 - ⇒ spezielle
 Transistorschaltungen als
 statisches Speicherelement
 - **⇒** Speicherung der Daten in einem Kondensator
- O Speicherung der kleinsten Informationseinheit (Bit) in einem Speicherelement

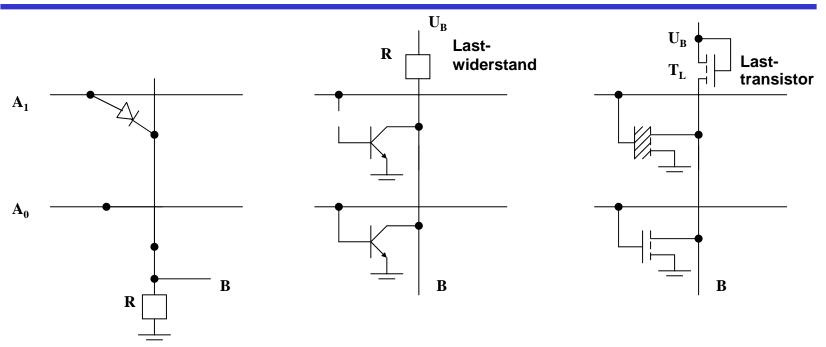


- Speicherzelle
 - ⇒ Speicherelemente, die unter einer gemeinsamen Adresse ansprechbar sind
- Speicherwort
 - **Datenbusbreite**
- Organisation
 - **⇒** Anzahl der Speicherzellen
 - **⇒** Anzahl der Speicherelemente
 - ⇒ n*m Bit
- Kapazität
 - **⇒** Zahl der Speicherelemente

Klassifizierung von Halbleiterspeichern

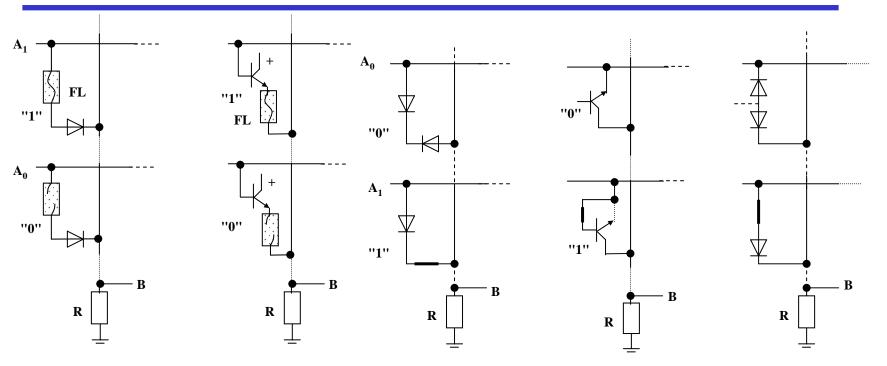


Speicherzellen für maskenprogrammierbare Speicherelemente



- Maskenprogrammierbare Speicherelemente erhalten ihre Information bei der Herstellung des Chips
 - **⇒** Information steht auf einer der Masken
 - **⇒** Inhalt ist nicht veränderbar
- O Bauelemente wie Dioden, Bipolar- oder MOS-Transistoren werden bei der Herstellung deaktiviert
 - ⇒ Bei MOS-Transistoren ist die Dicke der Gate-Isolation ausschlaggebend

Speicherzellen für programmierbare Speicherelemente

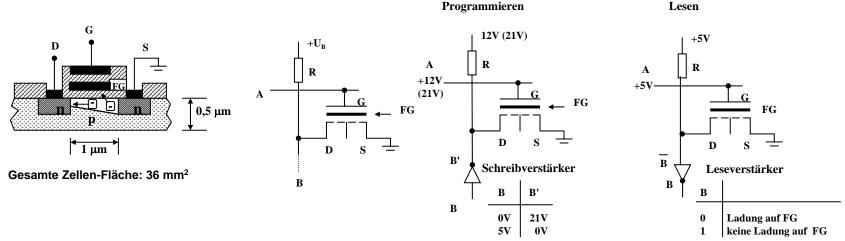


Speicherzellen mit Schmelzsicherungen

AIM-Speicherzellen

- O Programmierung in Programmiergerät durch Überspannungen
 - **⇒** Schmelzsicherung
 - **⇒** Zerstören von Dioden (dauernd leitend)
- O Information ist nur einmal schreibbar und kann nicht verändert werden

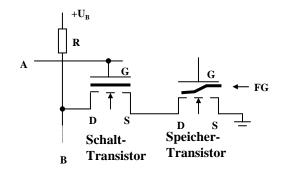
Löschbare Speicherelemente

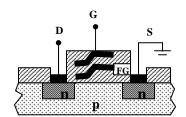


- O Löschen durch UV-Licht
- **O** FAMOS: floating gate avalance MOS-transisistor
 - ⇒ Besitzt zweites Gate, das vollständig isoliert ist
 - ⇒ Speicherung der Ladung über 30 Jahre
- O Programmierung durch hohe Spannung (12-21 V)
 - **⇒** Elektronen werden angezogen

- Programmieren und Lesen einer EPROM-Zelle
- Lesen durch Anlegen einer niederen Spannung (5 V)
 - ⇒ ist das Floating-Gate geladen, schaltet der Transistor nicht

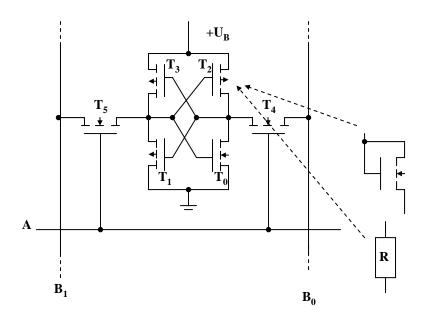
Elektrisch löschbare Speicherelemente





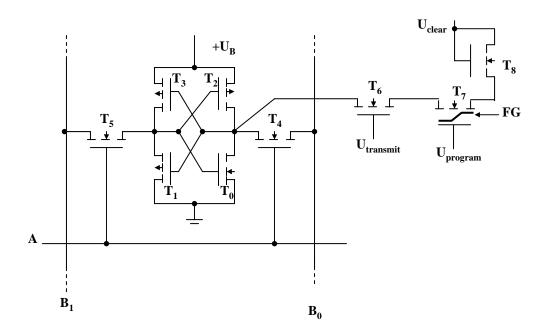
- **O Dünne Isolierschicht des Floating Gates**
 - ⇒ Lesen: Wenn das Floating Gate des Transistors geladen ist, sperrt dieser
 - \Rightarrow Löschen: Hohe Spannung (21 V) am Gate-Anschluß des Transistors lädt das Floating Gate ($U_B = 0V$)
 - ⇒ Programmieren: 0 V am Gate und eine hohe Spannung am Drain-Anschluß des Transistors entlädt einzelne Floating Gates (logisch 0)

Statische MOS-Speicherelemente



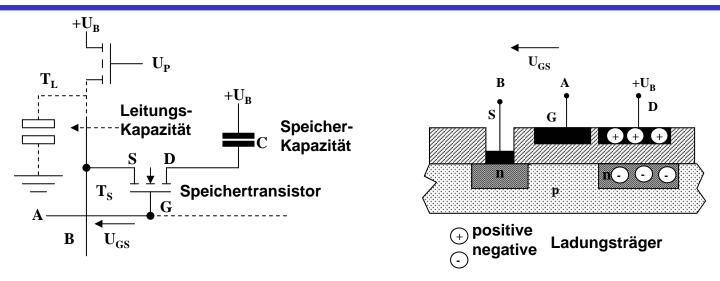
- **○** 6-Transistorzelle
 - ⇒ Statt T₂ und T₃ können auch n-MOS-Transistoren oder Widerstände eingesetzt werden
 - ⇒ T₄ und T₅ dienen zur Ankopplung an die Bitleitungen

NVRAM-Speicherelemente



- O Kombination eines statischen mit einem EEPROM Speicherelement
 - ⇒ wenn die Spannung abfällt oder das Gerät eingeschaltet wird, findet eine Übertragung von bzw. in die EEPROM-Zelle statt

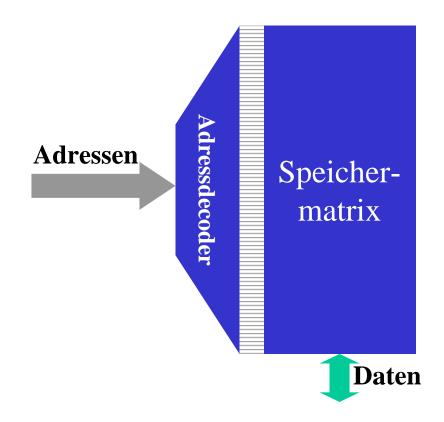
Dynamische Speicherelemente



- O Die Information wird in einem Kondensator gespeichert
 - ⇒ vergrößerte Drain-Zone
 - **⇒** isoliert zur Spannungsversorgung
- O Kapazität 0,1 bis 0,5 pF, 100.000 bis 150.000 Elektronen
 - ⇒ Selbstentladung nach ca. 2 ms
- O Speichern entspricht dem Laden des Kondensators
- Lesen entlädt den Kondensator
 - **⇒** Daten müssen wieder zurückgeschrieben werden

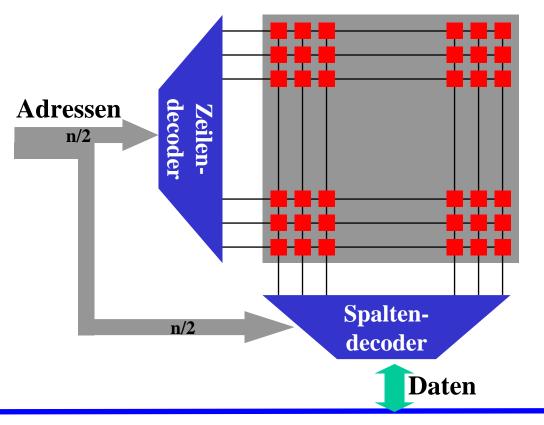
Äußere Organisation

- Organisation des Speicherbausteins als Wortbreite und Adressbereich
- O Beispiele: 512k*8, 4M*1

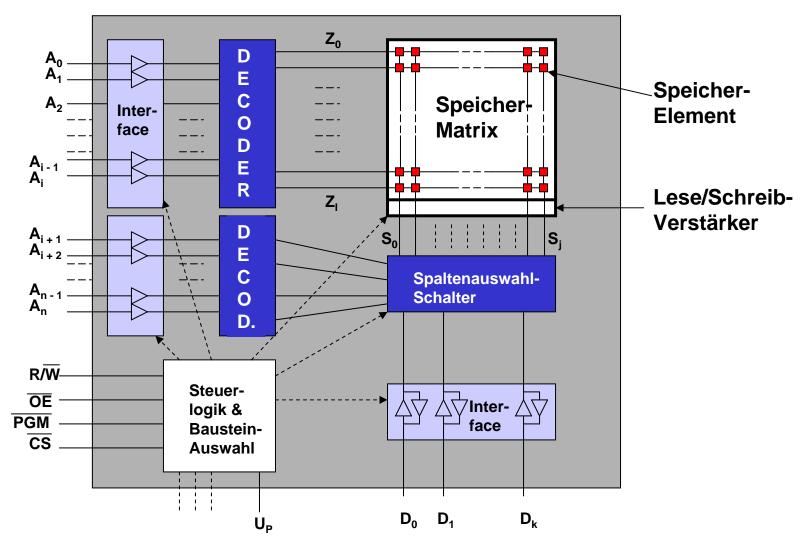


Innere Organisation

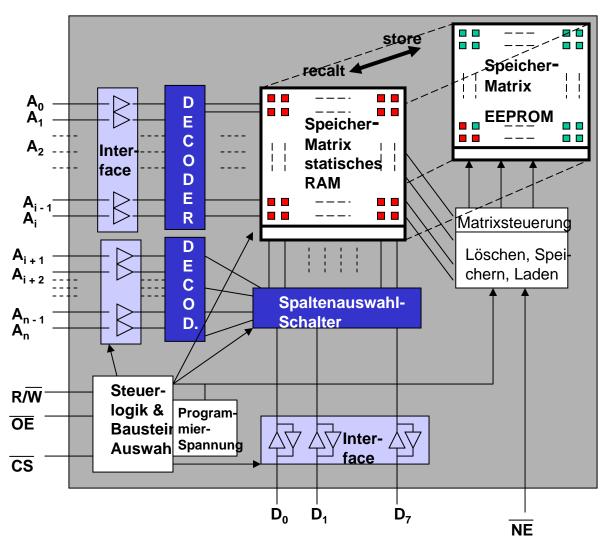
- O Anordnung der Speicherzellen in einer quadratischen Matrix
 - ⇒ ergibt die minimale Anzahl der Ansteuerleitungen
- O Aus den 2^{n/2} Datenbits werden im Spaltendecoder m Bits ausgewählt



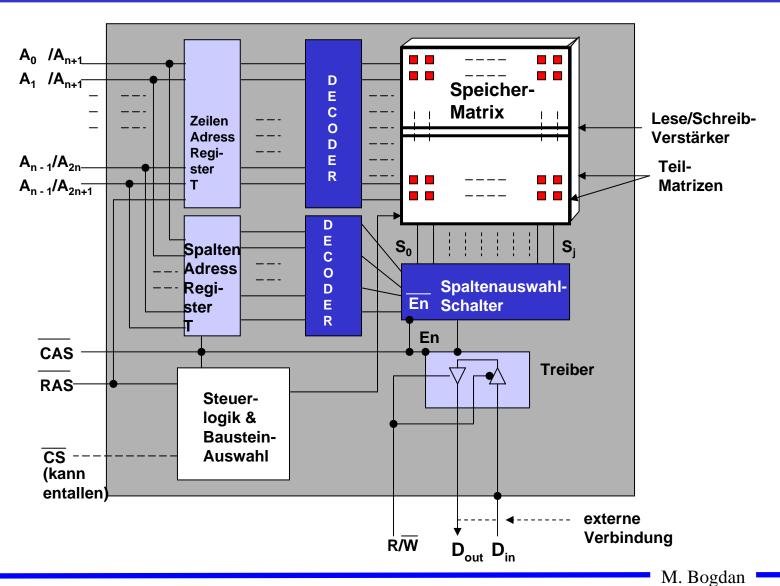
Aufbau eines Speicherbausteins



NVRAM-Bausteine

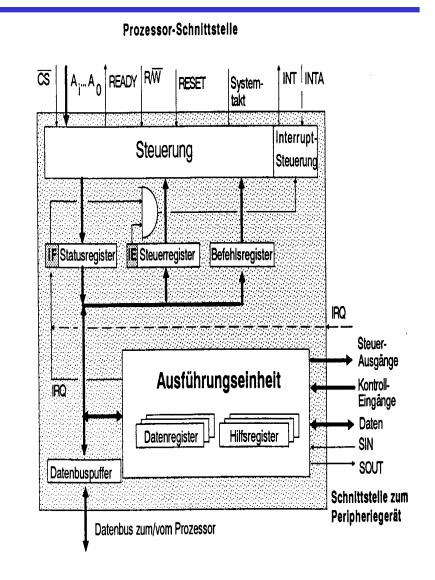


Dynamische RAM-Bausteine



10 E/A und Peripheriegeräte

- Ein- und Ausgabe erfolgt über spezielle Speicherstellen im Adressraum des Prozessors
 - **⇒** Memory Mapped
 - **⇒** spezielle I/O-Befehle
- Adressdekodierung erzeugt das CS-Signal (chip select)
- Der Prozessor kommuniziert über
 - **⇒** Datenregister (Lesen und Schreiben der Daten)
 - **⇒** Statusregister (Zustand des Bausteins)
 - ⇒ Steuerregister (Betriebsart des Bausteins)



Serielle Schnittstelle: RS232

O Synchronisation über den Aufbau des Datenworts

⇒ Start: Startbit

⇒ 1,...,n: 5 bis 8 Datenbits

⇒ P: Parität

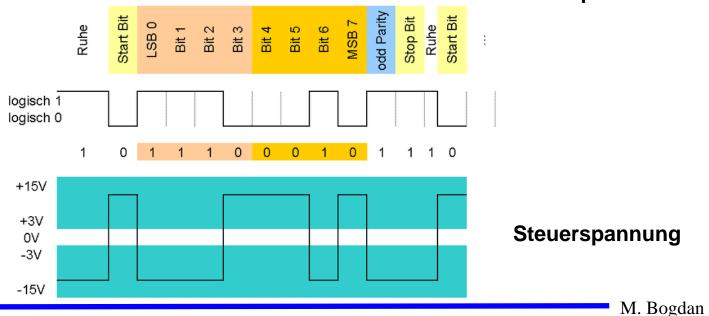
⇒ Stopp: 1, 1.5 oder 2 Stoppbits

Syncronisation
Daten low & high
Check

9600 8O1 = 9600 Baud; 8 Datenbits; odd Parity; 1 Stopbit

ASCII "G" = \$47 = 0100 0111

Beispiel: EIA 232 (RS232)



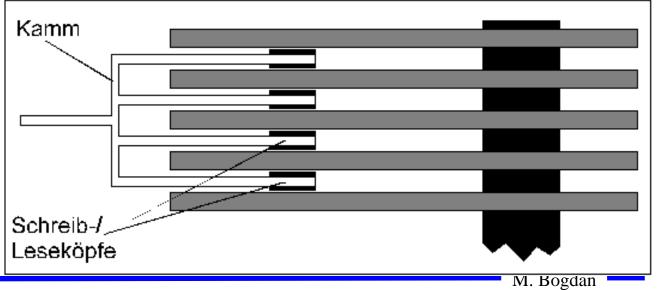
Die RS232-Schnittstelle

- **O** RTS: request to send
 - **⇒** Sendeteil einschalten
- O CTS: clear to send
 - **⇒** Übertragungseinrichtung sendebereit
- O DCD: data carrier detect
 - **⇒** Trägersignal erkannt
 - **⇒** Empfangsteil einschalten
- O DSR: data set ready
 - **⇒** Übertragungseinrichtung betriebsbereit
- O DTR: data terminal ready
 - **⇒** Empfangseinrichtung betriebsbereit

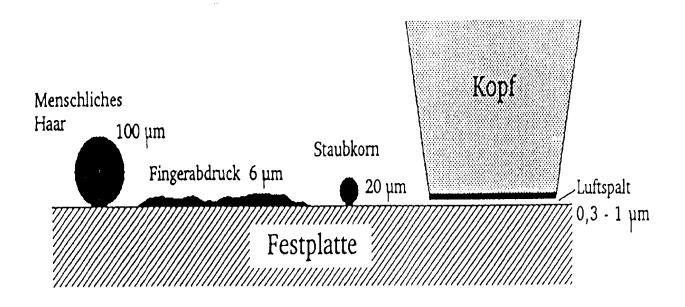
Aufbau eines Festplatten-Laufwerks







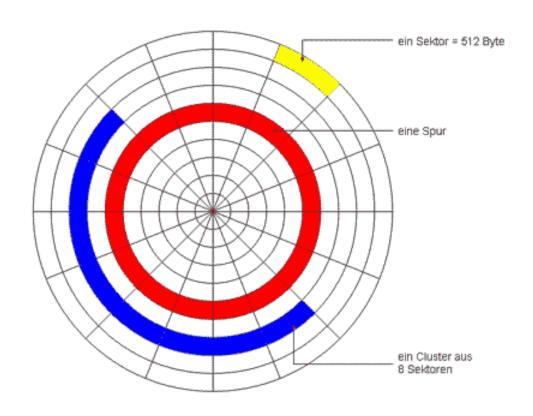
Größenverhältnisse im Festplatten-Laufwerk



Größenvergleich

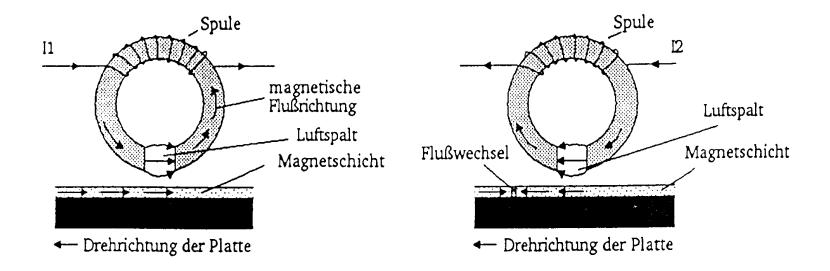
Sektoren einer Festplatte

- O Sektor: 512 Byte
- O Spur: "Lesestreifen"
 - ⇒ Sektoren auf äußeren Spuren sind flächenmäßig größer
 - **⇒ Trotzdem 512 Byte!**
- O Cluster: Verbund von Sektoren; Größe abhängig von der Partitionierung



Prinzip der Datenspeicherung

- O Das Prinzip der Datenaufzeichnung besteht darin, die Oberfläche der Platte informationsabhängig zu magnetisieren.
- Zur Unterscheidung der "0"- und "1"-Bits wird die Richtung der Magnetisierung verändert. Jede Änderung der Magnetisierungsrichtung wird als flusswechsel bezeichnet.



Zusammenfassung

O TI1

- **⇒** Elektrotechnische Grundlagen
 - Einfache physikalische Zusammenhänge, die verwendet werden um Schaltvorgänge in Rechnersystemen durchzuführen
- **⇒** Halbleitertechnologie
 - Funktionsweise von Dioden und Transistoren
 - Einsatz von Transistoren als Schalter
 - CMOS-Schaltungen
- **⇒** Digitale Grundlagen
 - Entwurf und Darstellung von Schaltnetzen

Zusammenfassung

O TI2

- **⇒** Digitaltechnik
 - Optimierung von Schaltnetzen und Schaltwerken
- **⇒** Komponenten digitaler Systeme
 - Funktion und Aufbau komplexer Bausteine
 - Komponenten aus denen Rechnersysteme aufgebaut sind
- **⇒** Rechnerarithmetik
 - Darstellung von Zahlen und Zeichen in Rechnersystemen
 - Algorithmen zur Berechnung von Operationen wie die vier Grundrechenarten
- **⇒** Aufbau und Funktionsweise einfacher Rechnersysteme
 - Komponenten
 - Busse
 - Speicher
 - Peripherie